



RE450-LF

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Sans trous
- Étamé à chaud (HAL-leadfree) avec un laque d'arrêt de soudure
- Platine d'adaptation pour 40 boîtiers QFP-, SOP-, SSOP- et SDIP env.
- QFP- 0,80 mm Pitch: 44, 56, 64, 72, 80, 94, 100, 120-Pin
- QFP- 0,85 mm Pitch: 48, 54, 56, 64, 68, 80, 100-Pin
- QFP- 0,50 mm Pitch: 48, 64, 72, 80, 100, 120, 144, 160-Pin
- SOP- 1,27 mm Pitch: max. 44-Pin en 225, 300, 375, 450, 525, 600 mil.
- SOP- 1,00 mm Pitch: max. 36-Pin en 225, 300, 375 mil.
- SSOP- 0,80 mm Pitch: max. 42-Pin en 300, 450 mil.
- SSOP- 0,65 mm Pitch: max. 30-Pin en 225, 300 mil.
- SDIP- 1,778 mm pas: max. 64-Pin en 300, 400, 500, 600, 750 mil.
- Dimensions 100 x 160 mm